附件4

重庆拟重点考察企业园区、企业简介

一、西永微电子产业园

‌**西永微电子产业园是重庆市为发展高新技术产业于2005年规划建设的电子信息专业化园区，以笔记本电脑、集成电路、光电等产业为核心，近年重点拓展人工智能、跨境电商等新兴领域，已成为西部（重庆）科学城的重要产业引擎。**‌

**（一）园区概况**‌

1.‌**定位与规模**

西永微电子产业园成立于2005年8月，规划面积37.42平方公里，是重庆市“十一五”期间重点打造的电子信息产业基地，也是中西部首个通过国家发改委审核的微电子专业园区。园区由综合保税区、软件及服务外包产业园、集成电路产业园等“一区五园”组成。‌‌

**2.核心产业布局**‌

‌**传统优势产业**‌：以笔记本电脑制造为起点，集聚了惠普、富士康、广达等世界500强企业，累计引进项目148个，合同引资额超365亿元。

**新兴领域**‌：近年重点发展人工智能高算力电路板（如重庆方正1.6T项目）、集成电路研发（电科芯片项目）及跨境电商，形成“科技+贸易”双轮驱动模式。

**3.近期动态**

‌**人工智能与集成电路：**‌

2025年西洽会上签约的重庆方正高密项目，聚焦1.6T高算力电路板，预计2026年投产后年增产值4亿元，将强化人工智能产业链。

电科芯片项目致力于高端驱动芯片国产化，覆盖新能源汽车、机器人等领域，降低进口依赖。

**跨境电商生态：**‌

西永跨境电商产业园已引进Amazon、京东国际等百余家平台，商品覆盖100多个国家，2024年交易量达562.22亿元。其天猫保税直营仓日处理订单6.5万单，为全国最大。

创新“三带动”模式（产业、物流、创新），提供全流程服务，并探索42项自贸试验区改革举措。

（三）‌‌**经济贡献**‌

2024年园区跨境电商进口额同比增长54%，集成电路与人工智能项目预计新增就业超200个岗位，持续推动成渝双城经济圈建设。‌‌

二、重庆芯联微电子有限公司

（一）企业简介

重庆市政府主导建设的12英寸高端特色集成电路工艺线项目覆盖55nm至28nm特色工艺，总投资超250亿元，公司定位为西部地区特色工艺晶圆制造龙头，聚焦车规级芯片研发与生产，旨在打造“设计-制造-封测”一体化产业链，服务汽车电子、工业控制、轨道交通等领域。

（二） 核心业务与产品

该公司专注三大类芯片研发与制造，车规级主控芯片（用于汽车电子控制单元及智能驾驶系统）、电源管理芯片（支持新能源汽车电池管理与驱动）、射频芯片（覆盖车载通信、工业物联网等领域），产品适配商用飞机、轨道交通、医疗电子等高端场景。

与长安汽车、庆铃集团等本地车企深度合作，构建本地化供应链，2024年7月获批半导体设备制造资质，实现全链条业务覆盖。

（三）近期动态

2024年天使轮融资获21.55亿元投资，由国家大基金二期领投，同年7月战略投资，国家大基金二期再次注资，强化汽车芯片制造布局。

三、华润微电子（重庆）有限公司

（一）企业简介

华润微电子（重庆）有限公司成立于2007年，前身为中航微电子，现为央企华润集团旗下IDM（设计-制造-封测一体化）半导体企业，聚焦功率半导体领域。是国内车规级功率半导体全产业链基地，承担国产替代核心任务，技术覆盖晶圆制造、封装测试全环节。

企业注册资本19.89亿元，2024年营收23.35亿元，员工1,176人（研发占比13%）。

拥有8英寸晶圆线（月产能4.7万片，工艺0.18微米）和12英寸功率半导体生产线（2024年达产）。

（二）核心技术与产品

产品覆盖功率器件（MOSFET、IGBT）、GaN器件、MEMS传感器，应用于新能源汽车充电桩、太阳能光伏逆变器、手机快充等。

（三）近期动态

12英寸线2024年产能达标，功率封测基地加速建设，总投资近120亿元。2025年6月新增GaN气柜阀箱、DC溅射设备升级等招标，强化氮化镓技术布局。

四、中电科芯片技术（集团）有限公司（中国电科芯片技术研究院）

（一）企业简介

电科芯片立足五十多年来的技术、资源积累，成体系布局数字集成电路、模拟集成电路、微声电子、半导体光电子、传感器等芯片技术发展，着力实施“以创新为引领、以市场为导向、以产品为核心、以工艺为支撑”总体发展思路，布局先进计算、5G通信、汽车电子、智慧文博、智能传感等产业板块发展，是强芯固基主力军，产业基础中坚力量。

 电科芯片现有员工12000余人，拥有15个国家级和省部级创新平台，1家上市公司，17家二级非上市控股公司，总部位于重庆，业务布局分布于长三角、京津冀、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等地区。

（二）产业生态与规模

电科芯片构建了覆盖设计、制造、封测的全产业链生态，布局六大产业板块：特种芯片、先进计算、5G通信、汽车电子、智慧文博、智能传感。产品应用于汽车电子（车规级MCU、电子驻车制动芯片、安全气囊点火芯片）、航天军工（高辐射运算放大器、卫星成像焦面组件）、绿色能源（光伏旁路开关、电池管理AFE芯片）智能终端（OLED微显示模组、紫外探测成像组件）。

五、OPPO（重庆）智能科技有限公司

（一）企业简介

OPPO（重庆）智能科技有限公司为OPPO全球最大生产基地，2016年成立，位于渝北临空前沿科技城，国家级绿色工厂/智能制造示范项目。注册资本4亿元，员工近4000人，2023年产值354亿元（日均1亿），手机年出货2065万台。

（二）核心产品与产能

产品线包含智能手机（Reno、Realme系列）、锂电池、智能家居设备，仅2023年，就推出了22款不同型号新产品。

设备数控化率90%，关键设备100%联网，生产效率提升15%。每小时下线1万台手机，日产量可达 7.5万台手机，2023年出口875万台（贸易额82亿元）。

六、重庆传音科技有限公司

（一）企业简介

重庆传音科技有限公司（简称“重庆传音”）是科创板上市企业传音控股的全资子公司，成立于2017年，注册资本6.18亿元，现已成为集团在西部地区的高端智能手机核心制造基地及全球化战略支点。公司定位为新兴市场智能终端研发与制造的智能工厂，依托母公司在全球新兴市场的领先地位（非洲市占率超48%），构建了覆盖研发-生产-销售-服务的全链条体系，2023年实现营收167.82亿元，净利润达14.71亿元，业务覆盖全球70余国（重点市场包括尼日利亚、印度、孟加拉等）。

（二）核心产品与技术布局​

公司主营TECNO、itel、Infinix三大品牌智能手机，产品聚焦高性价比与本地化体验创新：

1.硬件技术

自主研发散热技术（2024年获“均热板专利”CN114501150A）、多卡多待射频方案，满足新兴市场复杂网络环境需求；

2.软件生态

搭载自研移动操作系统HiOS，深度联合网易等企业打造本地化应用（如音乐平台Boomplay月活跃数超7500万，游戏中心月活跃数2100万）；

3.智能制造

重庆工厂实现精密贴片、自动化测试等工序90%自动化率，单线日产能3万台，支撑高端机型出口需求。

（三）全球化服务与产业协作​

传音构建了业内领先的全球化服务体系：

1.在迪拜、拉各斯等城市设立7大国际售后中心，全球服务网点超2000个，本地化维修响应时效＜48小时；

2.与深圳泰衡诺联合建设省级工业设计中心（2024年获批），在渝布局软件研发、供应链管理团队，强化“软硬件一体化”能力。

（四）近期动态与发展方向​

2024年新增“LPDDR芯片封装结构”“屏幕折痕控制机构”等14项核心发明专利，重点研发折叠屏、5G设备；持续扩建渝北工厂高端产线，提升智能终端出口规模，强化东南亚市场竞争力；布局IoT产品线（智能手表、平板电脑），打造多品类智能生态链。

七、明月湖实验室

实验室简介

明月湖实验室是重庆市重点建设的重大科研平台，由中国工程院院士、重庆大学教授潘复生牵头建设。实验室聚焦新材料新装备领域，重点开展新一代颠覆性储能材料、高性能轻量化材料、智能新材料和材料智能设计等方向的研究。旨在为重庆市打造万亿级材料产业提供技术支撑。目前，实验室已引进4个院士团队和10个专家团队，并取得多项国际领先科研成果。

实验室主要聚焦四大领域：新一代颠覆性储能材料、高性能轻量化材料、智能新材料、材料智能设计。截至2024年11月，实验室已引进4个院士团队、10个专家团队、8位首席专家、300余名科研人员。